



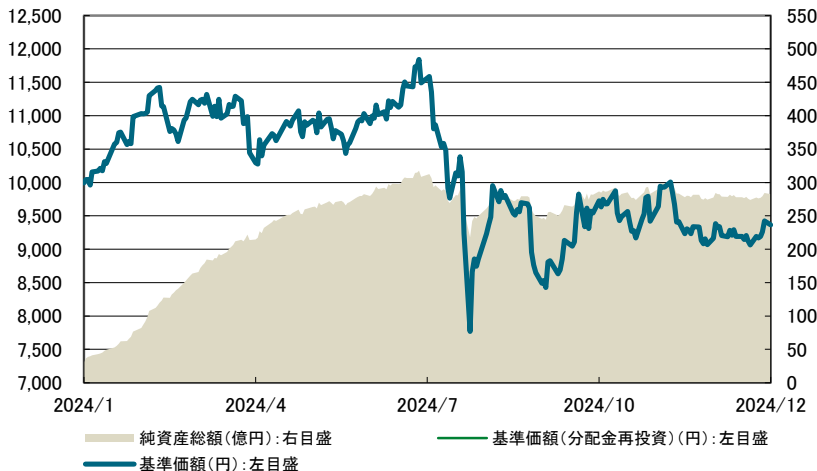
# 半導体関連 日本株式戦略ファンド 《愛称:半導体ジャパン》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2024年1月29日

作成基準日 : 2024年12月30日

## 基準価額の推移



- ※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
- ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

## 基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	9,365 円	+ 296 円
純資産総額	282.48 億円	+ 8.06 億円

## 期間別騰落率

	騰落率
1か月	3.26%
3か月	0.28%
6か月	-16.50%
1年	-
3年	-
設定来	-6.35%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 0 円

決算期	2025年1月	2026年1月	2027年1月
分配金	- 円	- 円	- 円

※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

## 個別銘柄が基準価額の変動に与えた影響度(月間、概算)

プラス要因銘柄	寄与額	マイナス要因銘柄	寄与額
MARUWA	+ 75 円	ローツェ	- 27 円
アドバンテスト	+ 52 円	KOKUSAI ELECTRIC	- 21 円
イビデン	+ 34 円	オルガノ	- 13 円
ソニーグループ	+ 32 円	信越化学工業	- 11 円
ダイフク	+ 27 円	トリケミカル研究所	- 9 円

### <本資料のお取り扱いにおけるご留意点>

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。



# 半導体関連 日本株式戦略ファンド 《愛称:半導体ジャパン》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2024年1月29日

作成基準日 : 2024年12月30日

## 資産の状況

※ 当ページの数値はマザーファンドベースです。

### 資産内容

株式	98.83%
株式先物取引	0.00%
短期金融資産等	1.17%
合計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

### 組入上位5業種

	業種	比率
1	電気機器	30.79%
2	化学	23.73%
3	機械	20.81%
4	ガラス・土石製品	11.56%
5	精密機器	5.99%

※ 対純資産総額比です。

### 規模別組入状況

規模	銘柄数	比率
大型株式	10	25.59%
中型株式	19	46.74%
小型株式	12	25.74%
その他	1	0.77%

※ 対純資産総額比です。

※ 規模別構成は東証規模別株価指数による分類です。TOPIX構成銘柄以外についてはその他に分類しています。

### 半導体技術領域別組入状況

半導体技術領域	比率
部素材	46.31%
製造装置	44.32%
生産等	8.20%

※ 対純資産総額比です。

※ 半導体技術領域は、当社の分類定義によるものです。

### 組入上位10銘柄

	銘柄	半導体技術領域	比率	会社概要
1	MARUWA	部素材	6.45%	セラミック材料技術を中核に、幅広い分野に材料や部品を供給。高シェアを有する高熱伝導基板は、車載パワー半導体に欠かせない製品
2	東京エレクトロン	製造装置	5.51%	半導体製造装置メーカー。半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング(ウエハー上の薄膜の加工)、洗浄プロセスに強みを有する
3	ディスコ	製造装置	5.25%	半導体や電子部品の製造工程で使用される精密加工装置を製造・販売。ダイシングソー(ウエハー切断装置)などにおいて、高いシェアを有する
4	アドバンテスト	製造装置	5.19%	メモリ半導体からロジック半導体、アナログ半導体など幅広い半導体デバイスの試験装置を製造・販売する
5	イビデン	部素材	4.72%	IC(集積回路)パッケージ基板を製造。主にCPU(中央処理装置)や、GPU(画像処理半導体)など、先端分野向けの基板を手掛ける
6	ダイフク	製造装置	4.70%	半導体製造で不可欠なクリーンルーム向け搬送・保管システムを世界有数のメーカーに提供している
7	レゾナック・ホールディングス	部素材	4.38%	高純度ガスやCMP(化学的機械研磨)スラリー、封止材、ダイボンディング(半導体素子を支持体に固定)フィルムなどの半導体材料を手掛ける
8	トリケミカル研究所	部素材	3.97%	半導体や光ファイバー用の材料を開発・製造・販売しており、半導体メーカー向けの高純度化学薬品が主力
9	フジインコーポレーテッド	部素材	3.86%	半導体基板の鏡面研磨や半導体チップの多層配線に必要なCMP(化学的機械研磨)に使用される研磨剤を製造・販売
10	住友ベークライト	部素材	3.65%	プラスチック製品の製造開発を行う化学企業。高いシェアを有する半導体封止用エポキシ樹脂成形材料のほか、感光性材料などを手掛けている

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 42

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



## 半導体関連 日本株式戦略ファンド 《愛称:半導体ジャパン》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2024年1月29日

作成基準日 : 2024年12月30日

### ファンドマネージャーのコメント

#### 【市場動向】

国内株式市場は上昇しました。

月前半は、公的年金が運用目標利回りを引き上げる方針との報道や米景気の底堅さから国内株式市場は上昇しました。その後も、中国景気の先行き不安が和らぎ中国関連株が買い戻されたことや、米CPI(消費者物価指数)が想定内の上昇となり米利下げの継続観測が好感されたことによる米ハイテク株高および円安・米ドル高から国内株式市場は上昇しました。

月後半は、FRB(米連邦準備理事会)が翌年は利下げを慎重に進めるとの姿勢を示したことから米長期金利が上昇し米株安となった影響で、国内株式市場は一時下落しました。その後は、米物価指数の上昇率が市場予想を下回ったことで米利下げペース鈍化への過度な懸念が後退したことや、自動車業界の経営統合およびトヨタのROE(自己資本利益率)目標引き上げの報道により、国内株式市場は上昇しました。

#### 【運用実績】

ダイサやグラインダなどの半導体製造装置で高い競争力を維持しているディスコや、製造装置において複数の分野で高い世界シェアを有している東京エレクトロについて、半導体産業の拡大に伴い持続的な成長が期待できることからウェイトアップを実施しました。一方で、付加価値の高いセラミック製品に対する需要拡大を背景に業績改善が見込まれるものの、株価上昇に伴う利益確定の観点からMARUWAを売却したほか、半導体製造装置向けの制御機器や計測機器に強みを有しているものの、自動車関連や、中国関連事業に対する不透明感が残存する堀場製作所のウェイトダウンを実施しました。

#### 【パフォーマンス状況】

基準価額は前月末比で上昇しました。

個別銘柄では、MARUWA、アドバンテスト、イビデンなどがプラスに寄与した一方、ローツェ、KOKUSAI ELECTRIC、オルガノなどがマイナスに影響しました。

#### 【市場の見通し】

欧米の景気減速や中国経済の停滞長期化への懸念が残存しているほか、短期的には日米の金融政策に対する思惑やそれに伴う為替動向等を背景に株式市場は変動率の高まる局面が予想されます。一方、先々を見据えては、欧米では景気動向を踏まえた金融緩和の継続が予想されることや、日本企業の業績動向は底堅く推移すると見込まれること、増配や自社株買いによる企業の積極的な株主還元策に加え、新NISAを活用した個人投資家資金の流入が期待できることなどから、底堅い展開を想定します。

WSTS(世界半導体市場統計)によると、2024年の半導体市場は前年比+19.0%のプラスとなり、前年比▲8.2%のマイナスとなった2023年から再拡大して着地するとみられています。そして、2025年には、前年比+11.2%と、更なる市場拡大が予測されています。

需要面では、力強い生成AI(人工知能)関連需要が確認できます。生成AI関連用途で利用される半導体には高い性能が必要とされるため、積極的な技術・研究開発投資が続いています。生成AI関連投資については、中長期的に重要性が高まるAI活用基盤を構築するための投資であると考えられ、当面は堅調さが持続するとみえます。PC・スマートフォン、産業機械、自動車市場については、需要回復ペースの遅れや在庫調整の長期化が指摘されるものの、今後はこうした生成AI関連以外の需要の緩やかな改善が進むと予想します。また、半導体の安定調達を目的として、世界各国・地域での半導体関連投資の増加が見込まれます。こうした状況を背景に、半導体関連企業は株式市場における評価が高まる局面にあると考えます。

2025年1月、米国ではトランプ氏が大統領に就任する予定となっていますが、政権移行に際して、日本の半導体関連銘柄に対する見通しに大きな変化はありません。短期的には、トランプ氏の言動が予測困難なことや関税導入に対する警戒感から、市場の変動性が高まる展開が想定されます。しかしながら、安全保障の観点から半導体投資の重要性が高い状況に変わりないことや、半導体業界に対する規制強化による影響は軽微であることが徐々に認識されると考えられることから、中長期的な産業へのマイナス影響は限定的とみえています。

#### 【今後の運用方針】

半導体は、幅広い用途で使用されるデジタル社会の重要基盤であり、これまで半導体の高性能化を背景に、多くのイノベーションが生まれてきました。今後もあらゆる産業の「根幹」として私たちの生活や産業に多くの変革をもたらす、社会のデジタル化の牽引役として、半導体産業は中長期的に成長していくことが期待されます。

当ファンドでは、半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等、半導体産業から業績面で恩恵を受ける半導体関連銘柄に注目し、企業の成長性やバリュエーション等を考慮して銘柄選別を行う方針です。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



# 半導体関連 日本株式戦略ファンド 《愛称:半導体ジャパン》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2024年1月29日

作成基準日 : 2024年12月30日



## ファンドの特色

- 主として日本の半導体関連企業<sup>※</sup>の株式に投資を行います。  
 ※ ファンドにおいて「半導体関連企業」とは、半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいいます。
- 半導体関連企業を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築します。

## 投資リスク

### 《基準価額の変動要因》

- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。  
 従って、**投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様にご帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

### 【株価変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

### 【信用リスク】

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

### 【特定の業種に特化した運用に係るリスク】

ファンドは、特定の業種に関連する企業の株式を選別して組み入れますので、市場全体の値動きと比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

### 《その他の留意点》

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。  
 これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。





## 半導体関連 日本株式戦略ファンド 《愛称:半導体ジャパン》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2024年1月29日

作成基準日 : 2024年12月30日

### お申込みメモ

- 購入単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入価額 … 購入申込受付日の基準価額とします。  
(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
- 換金単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 換金価額 … 換金申込受付日の基準価額とします。(信託財産留保額の控除はありません。)
- 換金代金 … 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
- 申込締切時間 … 原則として、販売会社の営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 換金制限 … ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入・換金申込受付中止及び取消し … 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。
- 信託期間 … 無期限(2024年1月29日設定)
- 繰上償還 … 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
  - ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
  - ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
  - ・やむを得ない事情が発生した場合
- 決算日 … 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)です。
- 収益分配 … 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
- 課税関係 … 課税上は株式投資信託として取り扱われます。  
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。  
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
なお、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

### ファンドの費用

#### 《投資者が直接的に負担する費用》

- 購入時手数料  
購入申込受付日の基準価額に**3.3%(税抜3.0%)を上限**として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託財産留保額  
**ありません。**

#### 《投資者が信託財産で間接的に負担する費用》

- 運用管理費用(信託報酬)  
運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下の通りです。  
純資産総額に対して**年率1.562%(税抜1.42%)**を乗じて得た額
- その他の費用・手数料  
有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度、監査費用等を日々、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



# 半導体関連 日本株式戦略ファンド 《愛称:半導体ジャパン》


追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2024年1月29日

作成基準日 : 2024年12月30日

## 委託会社・その他の関係法人の概要

- 委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(ファンドの運用の指図を行う者)  
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号  
 加入協会 : 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  
 ホームページ : <https://www.smtam.jp/>  
 フリーダイヤル : 0120-668001 受付時間 9:00~17:00 [土日・祝日等は除く]
- 受託会社 三井住友信託銀行株式会社(ファンドの財産の保管及び管理を行う者)



**SMTAM投信関連情報サービス**  
 お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。  
※LINEご利用設定は、お客様のご判断でお願いします。  
 ※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ[SMTAM投信関連情報サービス利用規約]をご確認ください。

## 販売会社

商号等	登録番号	加入協会			
		日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社鹿児島銀行 (委託金融商品取引業者九州FG証券株式会社)	登録金融機関	九州財務局長(登金)第2号	○		
株式会社十六銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第7号	○		○
株式会社長崎銀行	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第11号	○		
株式会社肥後銀行 (委託金融商品取引業者九州FG証券株式会社)	登録金融機関	九州財務局長(登金)第3号	○		
株式会社SBI証券 ※	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○
岡三証券株式会社 (加入協会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会)	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第53号	○	○	○
木村証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第6号	○		
九州FG証券株式会社	金融商品取引業者	九州財務局長(金商)第18号	○		
ぐんぎん証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2938号	○		
株式会社しん証券さかもと	金融商品取引業者	北陸財務局長(金商)第5号	○		
東洋証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第121号	○		○
光証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第30号	○	○	○
むさし証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第105号	○		○
楽天証券株式会社 ※	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○

※ 対面販売のみのお取り扱いとなります。

- ・ お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- ・ 販売会社は今後変更となる場合があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。